

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2024-082

## 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”、“公司”）本次拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

公司于 2024 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1686 号）同意，公司向不特定对象共计发行可转换公司债券 9,767,020 张，每张债券面值为 100 元，募集资金总额为 976,702,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）20,704,106.68 元后，募集资金净额为 955,997,893.32 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2022]6901 号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。

为规范募集资金的使用与管理,根据有关法律法规的规定,募集资金到账后,公司已对上述可转债募集资金进行了专户存储管理,公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电气有限公司已与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2022年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2022-099)。

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金金额为772,257,270.08元(含手续费),尚未使用的募集资金总额为194,384,249.61元,其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为182,992,435.64元,剩余11,391,813.97元存储于募集资金专项账户内;与实际募集资金净额955,997,893.32元的差异金额为10,643,626.37元,系公司暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益、活期存款账户结息。

## 二、募集资金投资项目情况

根据《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-062)、《2024年半年度报告》,截至2024年6月30日,本次发行的募集资金具体使用及节余情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资规模	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	预计待支付募集资金	利息及理财收益扣除手续费后净额	节余募集资金	是否已结项
1	储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)	21,686.00	21,226.30	15,569.28	1,664.98	359.55	4,351.59	是
2	智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)	40,215.26	39,222.75	31,198.02	5,006.87	440.44	3,458.30	是
3	节能环保输配电设备智能制造项目	49,457.29	17,600.82	12,906.53	4,551.74	262.43	404.98	是
4	补充流动资金	17,930.00	17,549.92	17,549.92	-	-	-	-
	合计	129,288.55	95,599.79	77,223.74	11,223.59	1,062.42	8,214.88	-

2024年7月2日,公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的议案》，同意公司将 2022 年 9 月可转债募集资金的募投项目“节能环保输配电设备智能制造项目”、“储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）项目”、“储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）项目”结项，节余募集资金转至自有资金账户用于永久补充流动资金。

### 三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第四十二次会议以及第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 28,000.00 万元（含本数）可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司第二届董事会第四十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-069）。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 261,498,088.33 元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。

截至 2024 年 9 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币 261,498,088.33 元募集资金提前全部归还至公司可转债募集资金专用账户并及时披露。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-080）。

### 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

目前可转债募集资金账户中的资金余额，均为已结项项目的待支付款项，根据相关合同约定，该部分待支付款项距离实际支付尚有一段时间。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司将根据募集资金投资项目的资金使用计划，在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

公司将随时根据募投项目的资金需求情况及时归还至可转债募集资金专用账户。

本次使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

## 五、已履行的审议程序

2024年9月23日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币8,000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。上述事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。

## 六、专项意见说明

### （一）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展利益的需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

### （二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：金盘科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定。金盘科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能提高募集资金使用效益，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对金盘科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司 董事会

2024年9月24日